

第44回 YJC実装技術セミナー (12/20) 開催ご案内

ニュース

投稿者 : admin

Posted on : 2016年11月14日

第44回 YJC実装技術セミナー

『新展開著しい実装技術・環境調和型ナノテクノロジーの動向を探る』

開催のご案内

最近の電子機器実装技術の新方向への展開は著しいものが見られます。その中で今回は電子部品、ICチップ実装の新展開状況と、環境調和に寄与する最先端のナノテクノロジー技術・製品のご紹介を頂きます。

奮ってご参加、ご討議頂きたく、ご案内いたします。

【主催】 よこはま高度実装技術コンソーシアム (YJC)

【協賛】 (一社)エレクトロニクス実装学会(JIEP)

電子部品・実装技術委員会

特定非営利活動法人サーキットネットワーク(NPO C-NET)

【日時】 平成28年12月20日(火) 講演会 : 13:30 ~ 17:15

技術交流会 : 17:30 ~ 19:00

【会場】 横浜国立大学・共同研究推進センター 2階セミナー室

横浜市保土ヶ谷区常盤台79-5

アクセス : http://www.ynu.ac.jp/access/pdf/bus_all.pdf

(横浜駅西口乗車 国大北下車, バスの進行方向に徒歩5分ほどで右側にある3階建ての建物の2階セミナー室)

【参加費】 次の団体会員 : 5,000円 非会員 : 8,000円

YJC会員・JIEP会員・NPO C-NET会員

*参加費は当日、会場にてお支払い下さい。領収書をさし上げます。

【お申し込み】 下記リンクをクリックし必要事項を入力しお申し込みください。

= => [こちらをクリック](#)

アクセス不可の方は末尾の「お問い合わせ先」までご連絡ください。

【プログラム】

全体テーマ : 『新展開著しい実装技術・環境調和型ナノテクノロジーの動向を探る』

13 : 30 ~ 13 : 40

1 . **ご挨拶** YJC理事長 白鳥 正樹

13 : 40 ~ 14 : 30

2 . 『 **薄膜プロセスによる 電子部品の進化と機能パッケージへのアプローチ**』

TDK株式会社 生産本部 モノ作りセンター 土門 孝彰 氏

14 : 30 ~ 15 : 20

3 . 『 **金属皮膜ゴムボールによるチップ実装サイズのコネクター接続技術**』

株式会社リトルデバイス 代表取締役 瀧澤 明道 氏

15 : 20 ~ 15 : 35

休 憩

15 : 35 ~ 16 : 25

4 . 『 **新たな方向に急展開するICチップ実装技術の動向を探る**』

2.5D FO-WLP TSV **バンプレスTSV** **ポストTSV**

よこはま高度実装技術コンソーシアム 理事 本多 進

16 : 25 ~ 17 : 15

5 . **環境調和型最先端ナノテクノロジー技術・製品のご紹介**

鉛フリー接合・配線・センサ等を中心に

株式会社環境レジリエンス 代表取締役 長澤 浩 氏

17:30 ~ 19:00

技術交流会 (横浜国大・第2食堂)

【お問合せ先】 YJC事務局 鷹野征雄 y-jisso@ml.ynu.ac.jp

特定非営利活動法人YUVEC <http://www.yuvec.org/>

よこはま高度実装技術コンソーシアム(YJC) <http://www.y-jisso.org/>

〒240-8501 横浜市保土ヶ谷区常盤台79-5

横浜国立大学 共同研究推進センター内

Tel : 045-340-3981 Fax : 045-340-3982

(以 上)